

平成 29 年 11 月 1 日

各位

会社名 株式会社日本エム・ディ・エム
代表者名 代表取締役社長 大川 正男
(コード番号 7600 東証一部)
問合せ先 I R部 棟近 信司
(03-3341-6705)

脊椎固定器具新製品「KMC Kyphoplasty システム」及び 「Mendec Spine 骨セメント・キット」の販売開始に関するお知らせ

株式会社日本エム・ディ・エム（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大川 正男）は、日本アメリカ株式会社製造販売の脊椎固定器具新製品「KMC Kyphoplasty システム」及び「Mendec Spine 骨セメント・キット」の販売を開始することを決定しましたので、お知らせいたします。

「KMC Kyphoplasty システム」及び「Mendec Spine 骨セメント・キット」は、米国で開発された BKP（Balloon Kyphoplasty：経皮的後弯矯正術）と呼ばれる新しい治療法で使用される風船状の手術器具及び医療用骨セメントであり、原発性骨粗鬆症による 1 椎体の急性期脊椎圧迫骨折で十分な保存加療によっても疼痛が改善されない症例に用いられます。

当社は、脊椎脊髄外科市場へ 2012 年 11 月「Vusion OS インターボディ Cage」、2014 年 1 月「Pagoda スパイナル システム」及び 2014 年 12 月「IBIS スパイナル システム」と米国子会社 Ortho Development Corporation 製造の脊椎固定器具製品を順次投入してまいりました。当該製品が加わるにより、脊椎固定器具分野での販売の拡大が期待できます。

記

1. 製品

製品名 : KMC Kyphoplasty システム
承認番号 : 22800BZX00184000
用途 : 経皮的後弯矯正術

製品名 : Mendec Spine 骨セメント・キット
承認番号 : 22800BZX00185000
用途 : 経皮的後弯矯正術



2. 販売開始予定

平成 29 年 12 月から販売予定

3. 今後の見通し

本製品は、第 47 期（平成 31 年 3 月期）の業績に寄与する予定です。

以 上